

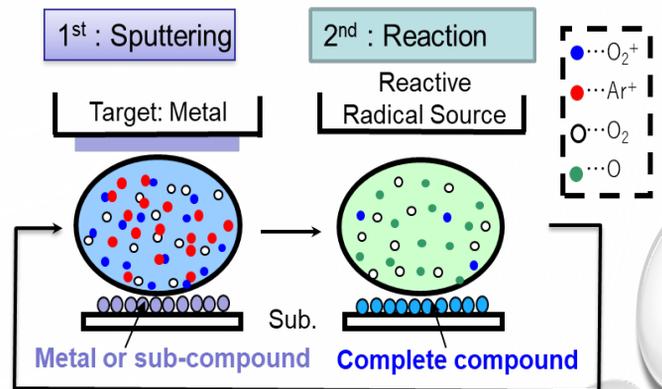
# P-RAS (Programmable RAS)

## Sputtering on demand

### Impact of Programmable Radical-Assisted Sputtering

#### 特徴

- 実績のあるスパッタリングと反応プロセスを分離したRASプロセスによる高速な反応スパッタ
- 最大4カソードを同期成膜制御
- 高性能 - 堆積プロセスのデジタル化
  - 金属スパッタリングとラジカル反応の交互プロセス
  - 原子層の精度で堆積が可能
- シンプル・コンパクト
  - AC100V駆動
  - オールインワンのキャスター移動
  - 外部ユーティリティによらない、循環冷却水仕様



RASプロセス概略

#### 新技術

- プログラマブルなデジタル・パターン・ジェネレータ (DPG)
  - プロセスのプログラム化
  - パルスDCスパッタとパルスガス導入による反応プロセスをプログラム化

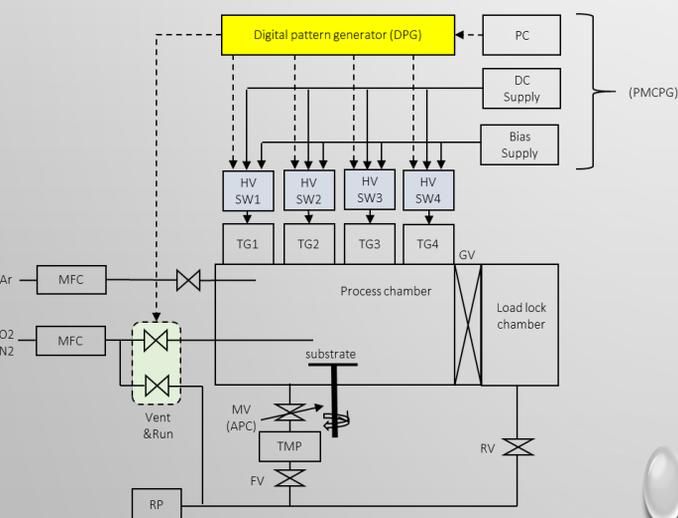
SHINCROON CO., LTD.

連絡先: (株)シンクロン  
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-5  
Tel: 045-650-2411

# P-RAS (Programmable RAS)



**Simple, Compact and High performance**



Schematic diagram of P-RAS system

## 仕様概要

|        |  |
|--------|--|
| 装置構成   | 成膜室 予備室 基板自動搬送                             |
| スパッタ制御 | Digital Pattern Generator                  |
| 基板(台)  | 2 インチ(4インチ搬送可能)                            |
|        | 基板回転 20 rpm<br>原点 ± 20 mm                  |
| カソード   | 2インチ 最大4カソード                               |
| ガス     | Ar, 反応ガス(O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> ) |
| 基板加熱   | Max. 700 °C                                |
| 所要電力   | 1f, 100 V, 4 KW                            |
| 据付面積   | W1500 x D900 x H1400mm                     |
| 総重量    | 450Kg                                      |